

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-86

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2026 年半年度报告摘要



2026 年 8 月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	弘信电子	股票代码	300657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王坚	郑家双	
电话	0592-3160382		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1#厂房 3 楼）		
电子信箱	hxdzstock@hon-flex.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,375,792,103.59	3,493,825,718.76	-3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,961,305.68	53,993,082.70	129.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,471,172.51	47,506,192.27	88.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-467,521,482.64	-51,051,874.87	-815.78%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.11	136.36%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11	136.36%

加权平均净资产收益率	8.91%	4.56%	4.35%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,171,369,816.84	8,101,105,015.21	13.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,867,893.75	1,330,663,747.74	17.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,316	报告期末表决权恢复的 优先股股东 总数		持有特别表 决权股份 的股东 总数		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持 股 比 例	持 股 数 量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
弘信创业工场投资集团股份 有限公司	境内非国有法人	17.46%	84,185,311		质押	35,489,285
厦门弘信电子科技集团股份 有限公司－2026 年员工 持股计划	其他	2.22%	10,684,200		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	3,062,573		不适用	
厦门海翼投资有限公司	国有法人	0.62%	3,000,061		不适用	
张志翔	境内自然人	0.43%	2,050,519		不适用	
许金雕	境内自然人	0.33%	1,574,149		不适用	
韩美娟	境内自然人	0.31%	1,493,900		不适用	
何艳	境内自然人	0.23%	1,120,000		不适用	
许自作	境内自然人	0.20%	974,300		不适用	
王建华	境内自然人	0.20%	962,300		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、股东弘信创业工场投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有 78,185,311 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 84,185,311 股； 2、股东厦门弘信电子科技集团股份有限公司－2026 年员工持股计划通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,684,200 股，实际合计持有 10,684,200 股； 3、股东许金雕通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,574,149 股，实际合计持有 1,574,149 股； 4、股东韩美娟通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,493,900 股，实际合计持有 1,493,900 股； 5、股东许自作通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 974,300 股，实际合计持有 974,300 股； 6、股东王建华通过普通证券账户持有 21,900 股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 940,400 股，实际合计持有 962,300 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 弘信电子 MTN001(科创债)	102501755	2025/12/09	2027/12/11	20,000.00	3.48%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	78.01%	79.76%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.44	5.90

三、重要事项

逐浪 AI，乘势而起。年初以来，以 OpenClaw、Seedance 等为代表的 AI 创新引领全球 AI Agent 生态全面爆发，AI Agent 驱动的端侧 AI 应用从“概念验证”大规模迈入“全民普及”阶段。Gartner 预测 2026 年全球 AI 支出达 2.52 万亿美元，同比增长 44%；IDC 预测到 2030 年 AI 解决方案对全球累计经济影响将达 22.3 万亿美元，占全球 GDP 的 3.7%。中商产业研究院预测 2026 年 AI 加速芯片市场规模预计达 3,813.9 亿元，年增达 59%；已建成 42 个万卡级智算集群，智能算力总规模超 1590EFLOPS 居全球前列。Token 经济的爆发正在重塑 AI 基础设施的产业格局，直接带动人工智能算力及端侧 AI 需求的爆发。

报告期内，公司经营结构持续改善，盈利能力大幅攀升。公司管理层针对 FPC 业务持续深化高端化战略，在逆势中成效显著；AI 算力业务在“五层蛋糕”生态理论指引下纵深推进，“算力底座+大模型+AI 应用”全栈生态持续完善。公司实现营业收入 337,579.21 万元，较上年同期下降 3.38%，归属于上市公司股东的净利润 12,396.13 万元，较上年同期增长 129.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,947.12 万元，较上年同期增长 88.34%。

（一）持续推进 FPC 高端战略，迎来结构性机遇

1、端侧 AI 渗透加速，有利公司 FPC 高端化战略升级

全球半导体及电子元器件市场呈现“需求分化、库存调整、技术跃迁”特征，端侧 AI 正式进入规模化落地阶段。个人 AI 智能体，需要具备全时感知、自然交互、端侧算力、个人记忆、隐私保护以及跨设备协同能力。上半年，AI 手机、AI PC、AI 眼镜等新品密集涌现，7 款手机端侧生成式 AI 服务获得网信办备案，表明手机内置模型及系统级 AI 功能正在被纳入监管框架，为端侧 AI 能力后续在国内手机产品中合规落地奠定基础。AI 正从“被动响应式工具”向“主动服务的智能体端点”跃迁，用户从“功能尝鲜”转向“价值刚需”。对 AI 终端提出了更高的要求，即“单设备功能增强”转向“全场景连续服务”。大模型在轻量化部署、端侧 AI 芯片、多模态交互等关键技术的突破，正全面推动智能终端从硬件架构到软件系统的升级。未来智能终端将呈现小型化、柔性化、场景化和人体工学化特征。AI 手机、AI PC、AI 眼镜等端侧 AI 有望进入新一轮软硬件协同升级周期，端侧 AI 创新和硬件升级带来的增量机会。



公司坚定推进 FPC 高端化战略，持续与行业头部客户的联合研发工作，通过在产品定义阶段深度介入客户下一代 AI 硬件的预研工作，将公司的高频互联解决方案前置嵌入其底层架构设计。随着高端侧 AI 设备的规模化放量，公司高附加值的 FPC 产品正在从“可选”变为“刚需”，为公司 FPC 业务长期高质量增长奠定了坚实基础。

2、终端市场结构性分化加速行业洗牌，头部集中效应日趋明显

智能手机市场经历了存储芯片涨价引发的深度结构性调整，头部集中效应日趋明显。根据 IDC 数据，2026 年第二季度中国智能手机市场出货量约为 6,601 万台，同比下降 4.3%，已连续五个季度出现同比下滑，但高端市场出货保持结构性增长，华为与苹果表现突出，第二季度出货量同比增幅均达 20% 左右，高端市场与低端市场的分化进一步加剧。年初以来存储芯片价格较去年同期上涨近 300%，内存成本在低端机型中占 BOM 总成本的 65% 以上，使得以低端产品为主的厂商盈利空间被大幅挤压，被迫减配、翻新老旧机型甚至重新推出 4G 版本以维持低价市场。终端市场的结构性分化直接传导至 FPC 行业：低端机型出货萎缩压缩了低端 FPC 的利润空间，尾部厂商在资金链紧张与技术迭代滞后的双重挤压下加速退出市场；而高端机型对 FPC 层数、线宽线距、材料等级和可靠性的要求持续提升，市场订单加速向具备高阶工艺能力、技术壁垒及稳健财务状况的头部企业汇聚。

折叠屏手机需求保持良好增长态势，正向“极致轻薄化”与“多形态化”方向持续演进。折叠屏体内部厚度极限压缩，对 FPC 在极小弯折半径下的百万次动态卷绕可靠性提出了极高要求，高阶刚挠结合板技术已成为不可替代的核心壁垒。AI 眼镜作为集成视觉、听觉、语音等多维感知的端侧硬件，在极其有限的镜腿空间内，连接摄像头、麦克风阵列与主板的 FPC 需达到微型化极限，同时承受频繁弯折，技术门槛与利润空间均处于高位。公司得益于早期在折叠屏技术、微型化 FPC 与多传感器集成方面的技术积累，公司已与多家头部客户在折叠屏及 AI 眼镜的 FPC 应用方案上展开合作。

公司凭借二十余年聚焦行业深耕与技术积淀，在产业布局、生产工艺、产品创新和综合客户服务能力方面形成了较为明显的竞争优势；同时，行业内兼具 PCB 和 FPC 业务的部份玩家，因 PCB 业务受益于 AI 景气正急剧扩张，减少了 FPC 业务的投入，也推动了业务机会向头部集中，从而使得公司的中高端 FPC 相关市场份额进一步提升，在 FPC 行业的市场地位和核心竞争力进一步凸显，经营结构与经营质量持续改善。

3、持续夯实智能制造，创新驱动 FPC 的把握 AI 端则历史性机遇

国家层面密集出台支持“新质生产力”发展的政策体系，《“十五五”数字经济发展规划》《关于加快推动新型显示产业高质量发展的指导意见》等文件明确将柔性电子、Mini/Micro LED、车用电子列为战略性新兴产业重点方向。在此背景下，公司所处的高端 FPC 及模组赛道获得强有力的政策托举与市场空间扩容，行业集中度加速提升，具备技术积累、规模效应与客户认证壁垒的企业优势进一步凸显。

公司坚持以技术与创新为驱动，持续升级技术平台、智能制造和客户服务体系，不断提升综合服务能力。报告期内，随着 AI 智能终端创新加速渗透，行业对研发、制造、质量和交付提出了更高的系统要求。公司正持续加大在核心技术领域的投入，以体系化的技术积累和工程能力，支撑产品迭代与规模化交付，在行业升级中保持竞争力。公司优先重点推进厦门翔海厂智能制造基地的生产工艺的自动化升级，上半年已累计导入自动化设备 169 台，生产自动化与效率、工艺精度与产品良率（成品良率 99.61%）均得到有效提升，生产成本与能耗同步下降，人均产值较上年同期增长 44%，随着自动化率的进一步提升，成本与能耗下降，能效和人均产值持续提升。公司 FPC 业务收入 164,535.48 万元，较上年同期下降 2.88%，毛利率 12.60%，较上年同期提升了 4.79 个百分点。FPC 业务已成为公司业绩持续增长的重要压舱石。

（二）推理算力需求加速释放，Token 工厂模式引领算力业务规模化发展

公司将持续通过 ALL IN AI 战略，以 AI 技术为核心驱动方向，逐步构建“芯片-系统-平台”的全栈能力，推动经营结构优化与战略转型升级。AI 技术的发展并非从实验室到产业的线性推进，而是消费级内容场景率先引爆规模，反过来拉动基础设施与模型能力的提升。2026 年以来，Seedance 等多模态视频大模型的爆发，以及 AI 视频创作与 AI 智能体的普及，成为国内 Token 调用量高速增长的核心引擎。公司 Token 工厂模式正是对这一产业趋势的落地回应。

1、推理算力成为核心增长极，Token 工厂成为新的商业模式

全球 AI 产业格局正在经历一场由“参数堆砌”向“Token 价值创造”的深层转型。产业重心从预训练环节向 AI Agent 商业化落地倾斜，标志着“Token 经济”正式成为驱动产业发展的核心引擎。Token 作为 AI 生成的逻辑基石，其工业化生产设施—Token 工厂，已成为衡量产业规模的关键载体。据国家数据局显示，截至 2026 年 3 月，国内 Token 日均调用总量已逾 140 万亿次。随着以 Claude Opus 5、

DeepSeek-V4、Kimi K3（2.8T 参数）为代表的尖端模型进入密集迭代周期，算力需求随模型能力的进化呈指数级增长。Token 消耗量正在成为企业衡量 AI 转型进度、业务智能化水平乃至员工生产力的关键指标。Token 工厂的核心价值在于实现了从“卖硬算力”到“卖服务”的价值飞跃。

公司管理层精准把握这一产业拐点，以 Token 工厂模式为核心，推动算力业务进入规模化运营阶段。围绕国家“东数西算”工程，公司已形成西部算力节点与东部研发、市场及服务需求相衔接的整体布局，重点关注绿色低碳、节能降耗、基础设施稳定性及算力资源的跨区域协同。目前，绿色能源条件已成为 Token 工厂能源层的重要支撑。公司已构建以庆阳为核心，辐射北京、上海、厦门、无锡等多节点的全国多元异构算力网络。布局东部算力网络更贴近产业与应用需求，便于开展技术服务和客户响应，形成与西部算力供给的有效互补。公司正为国内头部大模型企业、互联网巨头及垂直行业客户提供稳定、可持续的算力服务，客户认可度持续提升，业务规模与覆盖范围同步扩大，算力商业化路径已初步跑通。

3 月，公司与常熟市人民政府达成战略合作，燧弘华创全国总部正式落地，启动“云创算谷”建设，构建涵盖算力底座、大模型与 AI 应用的全栈智算生态，推动形成具有竞争力的 AI 智算产业集群；5 月，燧弘华创首个华为昇腾 384 超节点算力集群落地，Token 工厂总部正式落户无锡，顺利完成 Token 工厂项目及华为超节点集群项目签约；7 月，燧弘华创联合福建移动、趋境科技、信投智科等多家生态伙伴在厦门国际数据枢纽港布署福建省内首个华为 384 超节点及异构算力，搭建国内面向海西、辐射东南亚与金砖国家的标准化 Token 生产与出海交付平台，具备 Token 规模化出海交付能力。公司持续完善算力生态与布局，构建覆盖国内、辐射海外的 Token 生产与交付网络，积极探索中国 AI 服务全球化发展的新路径。Token 工厂的落地标志着公司以国产算力为核心的商业化运营进入实质性集群落地阶段，也是对这一新模式探索的关键节点。

2、HonMaaS 全栈赋能，AI 智能体开箱即用

公司构建了强大的供应链与运维技术的壁垒，通过渠道优化与交付模式升级，提升了“改制改配+组装+测试+上架压测”的一站式服务能力；同时，公司建立了一支具备芯片级维修能力的专业团队，大幅缩短了客户故障响应周期，不仅为客户业务连续性提供了坚实保障，更通过售后维保能力的构建，形成了“销售-交付-运维”的完整技术闭环。公司自主研发的“燧弘智算云平台”已上线，并以智算平台和 HonMaaS（模型即服务）能力为技术底座，将大模型 API、资源管理、多模型接入、模型调度及服务交付等复杂能力进行统一封装，降低企业使用前沿大模型的技术门槛，实现了从“卖算力”向“卖服务”的价值延伸。

HonMaaS 支持账号权限、调用额度、资源使用等统一管理，并提供使用数据与调用情况的可视化报表，帮助企业清晰掌握模型服务使用状况，实现资源使用的可视、可控与可追溯。依托深厚的技术积累，HonMaaS 已在 Qwen 3.6、DeepSeek-V4、GLM-5.2、Kimi K3 等模型发布后第一时间完成适配部署。

目前已持续接入 DeepSeek、Kimi、Qwen、GLM 等多款头部模型，通过统一的服务接口实现多模型接入，企业无需针对不同模型重复建设调用体系，即可根据业务需求灵活选择模型。5 月，燧弘华创正式推出 OpenClawAI 智能体一体机全系产品。该系列基于两款差异化硬件机型，深度整合自研 HonMaaS 模型服务平台，构建“硬件+平台+模型+服务”的全栈闭环。设备出厂即预装 OpenClaw 运行系统，直连 HonMaaS 远程模型 API 服务，实现“插电联网即用”开箱即用。

3、持续构建产业生态，推动“五层蛋糕”AI 生态建设

算力业务从“硬件销售驱动”向“硬件+服务”驱动的战略转型持续推进。公司以“国芯国模国用”战略为引领，加强与芯片、服务器、平台、模型、应用及产学研机构的交流合作。AI 算力业务正从硬件制造与算力资源服务供给，逐步向 Token 工厂模式下的能源协同、资源调度、平台管理、模型服务、运行维护及应用支持等综合能力延伸。公司持续与产业链合作伙伴推进国产算力技术路线与生态协同，通过硬件适配、联合研发与服务方案衔接，完善从底层算力到上层应用的配套体系。能源层：庆阳“源网荷储”一体化+绿电交易，以西部清洁能源支撑低成本算力；芯片层：NVIDIA（英伟达）、华为、燧原科技等深度协同+多元异构资源，推进多元异构资源、国产算力芯片适配及联合研发；算力层：NVIDIA（英伟达）、“华为昇腾 384 超节点”核心交付，构建高密度、高效率算力基础设施；模型层：HonMaaS（模型即服务），DeepSeek、Kimi、Qwen、GLM 等多款头部模型训练与推理服务；应用层：政务、交通、医疗、教育、金融、安全等多个领域的应用。

报告期内，公司算力业务营业收入 146,547.05 万元，较上年同期下降 1.10%。公司算力业务营业收入的结构进一步优化，其中，算力设备销售营业收入 112,617.72 万元，较上年同期下降 6.10%；算力资源综合服务营业收入 33,929.34 万元，较上年同期增长 20.13%，算力资源综合服务营业收入占算力及相关业务营业收入已达 23.15%，较上年同期提升了 4.09 个百分点。2026 年上半年公司新增算力资源综合服务订单 45.84 亿元，累计签约算力资源综合服务订单 97.44 亿元，已结算 18.13 亿元。

（三）坚持创新驱动，持续构建 AI 时代的核心竞争力

公司始终坚持将技术创新作为发展的核心驱动力，持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入 7,632.55 万元，较上年同期增长 3.54%。公司持续推进产学研协同创新，与清华大学、香港大学、兰州大学、厦门大学、西湖大学等高校的合作研发项目有序推进。公司充分发挥产业链及产学研协同创新优势，联合上游供应商在 AI 芯片、存储芯片、光模块、电源管理芯片、BMC 系统、高速网络交换机、液冷技术等关键技术上协同重点突破。

截至报告期末，公司（含子公司）已获得授权专利 693 项，其中授权发明专利 135 项、实用新型专利 552 项、外观设计专利 6 项。此外公司获得软件著作权 150 项、美国专利 1 项；正在申请中的发明专利 88 项、实用新型专利 58 项、软件著作权 22 项。

（四）多渠道融资并举，优化资本结构

继公司 2025 年度第一期中期票据（科技创新债券）在中国银行间市场成功发行，发行规模 20,000 万元，是债市“科技板”推出以来福建省发行的首单民营中长期科技创新债券；2026 年 3 月，燧弘华创通过增资扩股引入外部投资者苏州吴越弘创创业投资合伙企业（有限合伙），以 20,000 万元认购燧弘华创新增注册资本 526.3158 万元；2026 年 6 月，无锡燧弘拟以投前估值 300,000 万元引入外部战略投资者无锡市新吴区科产源质投资合伙企业（有限合伙），出资额 50,000 万元；2026 年 7 月，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，目前相关工作正有序推进中。

公司积极推动多渠道融资、主动优化资本结构，是提升长期核心竞争力的系统性安排。多渠道融资有助于拓宽资金来源、分散单一渠道风险、保障不同市场环境下的资金需求，同时发挥财务杠杆效应降低综合融资成本、提升资本回报水平，确保融资节奏与产业周期、业务需求相匹配，避免资金约束制约战略落地。